STANDARDLAGENAUFBAU HDI

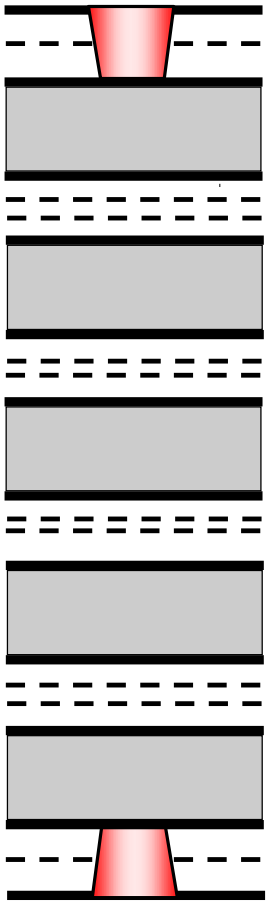
HDI12_1+10+1_1,60_17.5

12 - Lagen

Kerne: 0,15 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 10 + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**66**	
2	2			17,5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
3	3			17,5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
4	4			17,5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
5	5			17,5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
6	6			17,5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
7	7			17,5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
8	8			17,5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
9	9			17,5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
10	10			17,5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
11	11			17,5 µm		**16**	
					1 x 1080	**66**	
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1602

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,60**	+/-	0,12	mm			Datum: Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,69	+/-	0,15	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,75	+/-	0,17	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
28.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00	3+